

# AI반도체

[공동연구/2020](#) -4월 -인공지능 반도체 대규모 연구개발사업 수행기관으로 참여(2020.04)

- 관련기사: <뉴스H> 2020.04.24 [한양대, 인공지능 반도체 대규모 연구개발사업 수행기관으로 참여](#)
- 과학기술정보통신부(과기정통부) ‘인공지능(AI) 반도체 대규모 연구개발사업’의 2020년 신규과제 수행기관으로 선정
- 한양대는 4대 분야 중 서버(SK텔레콤 컨소시엄), 모바일(텔레칩스 컨소시엄), 엣지(넥스트칩 컨소시엄) 3개 부분에 참여해 [공동연구](#)를 진행할 예정
- AI 반도체 1등 국가 도약을 위한 대규모 연구개발 사업을 위해 총 4개 컨소시엄, 28개 수행기관(기업 16곳, 대학 10곳, 정부출연연구기관 2곳)을 선정 완료하고 본격적인 기술개발에 착수
- 분야별 기술 공유·연계와 연구 성과의 결집을 위해 각 세부 과제를 통합하고 산학연 컨소시엄 형태로 추진
- 목표: 서버, 모바일, 엣지, 공통 4대 분야 독자 AI 반도체 플랫폼 확보
- 계획
  - 과기정통부는 2020년 288억원 등 향후 10년간 2,475억원을 투입
  - 높은 연산성과 전력효율을 갖는 AI 반도체(NPU, 신경처리망장치) 10개 상용화를 목표로 개발
  - 초고속 인터페이스·소프트웨어까지 통합적인 개발로 AI 반도체 플랫폼 기술을 확보
- ‘서버’ 분야:
  - SK텔레콤 총괄로 한양대를 비롯해 15개 기관이 참여
  - 최대 8년간 708억 원을 투입해 클라우드 데이터센터 등 고성능 서버에 활용 가능한 AI 반도체와 인터페이스를 개발
- ‘모바일’ 분야:
  - 텔레칩스 총괄로 한양대 포함 11개 기관이 참여
  - 5년간 총 460억 원을 투입해 자율주행차와 드론 등 모바일 기기에 활용하는 AI 반도체를 개발
- ‘엣지’ 분야:
  - 넥스트칩 총괄, 한양대 포함 17개 기관이 참여
  - 5년간 419억 원이 투입해 영상보안과 음향기기, 생체인증보안기기 등 사물인터넷(IoT) 기기에 활용 가능한 AI 반도체를 개발